



VIA Technologies, Inc.

531 Zhongzheng Road, 1F | Xindian Dist, New Taipei City 231 | Taiwan
Tel: +886-2-2218-1838 | Fax: +886-2-2218-8924 | www.viatech.com

**VIA、Embedded Technology 2018 / IoT Technology 2018 おいて、
最新のエッジ AI 端末や AIoT ソリューションを公開**

2017 年 11 月 12 日 台湾・新北市 - VIA Technologies, Inc.は、11 月 14 日から 16 日まで、パシフィコ横浜で開催される「Embedded Technology 2018／組込み総合技術展」および「IoT Technology 2018／IoT 総合技術展」の日本マイクロソフト株式会社様のパビリオン内にブースを設け、Microsoft Azure IoT Edge 認証取得済みデバイスや Windows 10 IoT Core 対応デバイス、顔認証システムなどを展示いたします。



組込み総合技術展

Embedded Technology 2018



IoT 総合技術展 Internet of Things Technology

IoT Technology 2018

日本マイクロソフト株式会社様のパビリオン内の VIA Technologies ブース(A-01 S)およびソフトバンク・テクノロジーズ株式会社ブース(A-01 L)では Microsoft Azure IoT Edge 認証取得済みデバイスである「Artigo A820」によるビル内の温度・湿度管理のデモを行なうほか、「VAB-820」を使って Windows 10 IoT Core + Microsoft 顔認証 API によるフェイストラッキングのデモを披露する予定です。また、チップワンシステムズブース(C-18)では「ALTA DS3」とネットワークカメラの組み合わせで顔認証およびデータ解析のデモを、アーム株式会社ブース内の APS ブース(B-27)および富士通エレクトロニクス株式会社ブース(D-04)では「SOM-9x20」による顔認証システムのデモを披露します。

VIA、Embedded Technology 2018 / IoT Technology 2018 おいて、 最新のエッジ AI 端末や AIoT ソリューションを公開

2/2

「Embedded Technology 2018／組込み総合技術展」および「IoT Technology 2018／IoT 総合技術展」の概要は下記のとおりです。

Embedded Technology 2018／組込み総合技術展

IoT Technology 2018／IoT 総合技術展

会期： 2018 年 11 月 14 日～16 日 10:00 - 17:00 (15 日は 18:00 まで)

会場： パシフィコ横浜

URL: <http://www.jasa.or.jp/expo/>

VIA Technologies, Inc.について

VIA Technologies, Inc.は、高度に統合された組み込み用プラットフォームと、ビデオウォールやデジタル看板からヘルスケアや企業オートメーションまでにわたる M2M、IoT、そしてスマートシティアプリケーションの開発において国際的に主導的な役割を果たしています。本社を台湾・台北におき、VIA の国際的なネットワークはアメリカ、ヨーロッパ、そしてアジアのハイテクセンターを結び、顧客層は世界中の最先端のハイテク、通信にまでわたっています。詳しくはこちらをご覧ください。

<http://www.viatech.com/>

お客様からのお問い合わせ先

VIA Technologies Japan 株式会社

メールアドレス: mktjp@viatech.co.jp

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ

Richard Brown (VIA Technologies, Inc. 国際マーケティング担当 VP)

メールアドレス : RIBrown@via.com.tw

HaNaRe PR Group (VIA Technologies, Inc. 日本広報代理)

メールアドレス : press@hanare-pr.jp

記者ならびに編集の方々へお願い: VIA はすべて大文字で表記してください。